

I2FLEX

INTÉGRATION IMPRIMÉE SUR SUPPORT FLEXIBLE

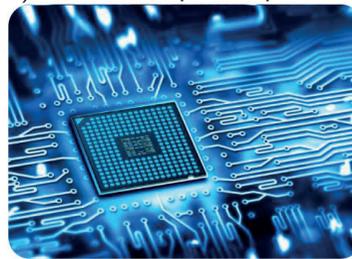
> OBJECTIF DU PROJET

La stratégie du consortium I2FLEX est de valoriser et perfectionner les technologies d'électronique imprimée en levant les verrous technologiques pour :

- Développer une approche d'interconnexion hybride puces et électronique imprimée à basse température sur différents substrats (papier, teslin, PC, PET) ;
- Développer des composants réalisés à la demande en électronique imprimée dans le but d'intégrer des systèmes de support souple, à faible coût pour la filière étiquette intelligente (tag RFID...), capteur autonome / intelligent et carte à puce.

L'objectif du projet I2FLEX est de réaliser en grande partie par jet de matière, à la demande des partenaires industriels, des objets communicants à faible coût. Pour cela, il est nécessaire de fiabiliser les sources des matériaux « jetables » et les procédés pour l'interconnexion hétérogène sur support souple de module multi-composants silicium/électronique imprimée. La technologie d'impression LIFT assistée par laser est automatisée et évaluée en parallèle.

Le but global est de démontrer la faisabilité de ces technologies en tant que moyen de production pour une nouvelle génération de « smart objects » bas coût, tant au niveau des performances techniques que des performances économiques des procédés de fabrication.



> PORTEUR DU PROJET



> PARTENAIRES



> FINANCEMENT

- Année de sélection : 2010
- Appel à projets : FUI 9
- Financeurs :



- Durée du projet : 36 mois
- Budget : 4.7 M€

> RETOMBÉES ATTENDUES

- Plus de 40 emplois
- Plus de 40M€ de chiffre d'affaires



MICROÉLECTRONIQUE



SANS CONTACT

